

編集後記

2023年度の第1号では3件の研究紹介と5件の受賞報告等がありました。研究紹介の最初の1件はディラック半金属におけるフロッケエンジニアリングというタイトルで物質の性質をレーザーにより詳細に調べたものです。次の2件はどちらも新物質合成に関するものでアンパイポラ有機半導体材料と磁歪材料です。前者は有機半導体では困難な大気中での電子輸送ができる材料を、後者は磁場で体積が変わる量がとても大きい材料を発見したことが面白い点です。受賞報告や学会報告は多くが写真付きで紹介されており、ぜひご覧ください。そして、今号の特徴的な点は新旧所長のまとまったコメントが掲載されていることです。森所長前所長の総括及び廣井新所長の構想の一部をぜひ熟読して頂いて、お二人の考えを共有して頂ければと思います。

三輪真嗣

物性研だよりの購読について

物性研だより発行のメール連絡を希望される方は共同利用係まで連絡願います。

また、物性研だよりの送付について下記の変更がある場合は、お手数ですが共同利用係まで連絡願います。

記

1. 送付先住所変更（勤務先⇔自宅等）
2. 所属・職名変更
3. 氏名修正（誤字脱字等）
4. 配信停止
5. 送付冊数変更（機関送付分）
6. メール配信への変更

変更連絡先：東京大学物性研究所共同利用係

〒277-8581 柏市柏の葉 5-1-5

メール：issp-kyodo@issp.u-tokyo.ac.jp